
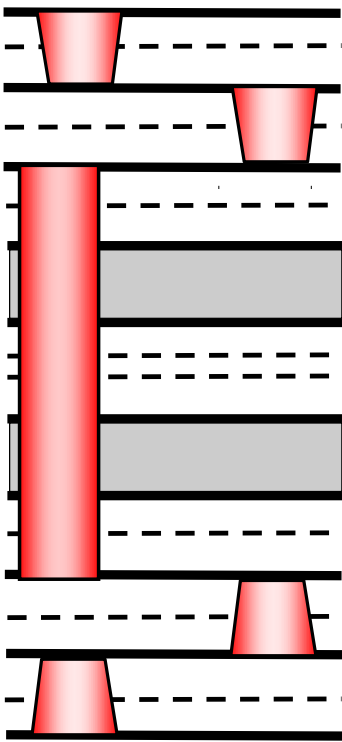


LAGENAUFBAU HDI (Standard)														
HDI10_2+6b+2_1,50_35			10 - Lagen							Kerne: 0,36 mm Cu 35/35 µm				
WE-Artikel Nr.:		2 + 6B + 2												
KUNDE:														
LAGENBEZEICHNUNG		AUFBAU			BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE	KUNDEN-FORDERUNG					
KUNDE	WE							[µm]	[µm]					
1	TOP/VS				Folie	12 µm	1)	12						
									1 x 1080	60				
2	VSK2				Folie	12 µm		30						
									1 x 1080	60				
3	VSK1				Folie	12 µm		35						
									1 x 1080	60				
4	2					35 µm		33						
					0,360 mm			360						
5	3					35 µm		33						
						2 x 1080	124							
6	4		35 µm		33									
		0,360 mm			360									
7	5		35 µm		33									
						1 x 1080	60							
8	RSK1		12 µm		35									
						1 x 1080	60							
9	RSK2	Folie	12 µm		30									
						1 x 1080	60							
10	BOT/RS	Folie	12 µm	1)	12									
					1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 55 µm									
					Gesamtdicke Material: 1490									
					Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)									
MATERIALDICKE:		1,50	+/-	0,13	mm	Datum:		Bearbeiter:						
DICKE über galv. Endoberfläche		1,59	+/-	0,16	mm									
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer		1,65	+/-	0,18	mm									
Kundenforderung:			+/-		mm	Messstelle:								
Erstellt am		von		Geprüft am		von		Freigegeben am						
28.03.2006		S. Keller		04.05.2006		M.Kress		04.05.2006						
								Revision						
								00						
								Seite: 19+						